

製品仕様一覧

製品名称		MAGNIA R3310F			
形名		/s	/l		
形番		TN8100-2602T	TN8100-2603T		
CPU	対応 CPU	インテル® Xeon® プロセッサ Bronze 3104(6C/6T, 1.70 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Bronze 3106(8C/8T, 1.70 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4108(8C/16T, 1.80 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4110(8C/16T, 2.10 GHz, 11MB, TDP 85W), Silver 4112(4C/8T, 2.60 GHz, 8.25MB, TDP 85W), Silver 4114(10C/20T, 2.20 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Silver 4116(12C/24T, 2.10 GHz, 16.50MB, TDP 85W), Gold 5115(10C/20T, 2.40 GHz, 13.75MB, TDP 85W), Gold 5118(12C/24T, 2.30 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 5120(14C/28T, 2.20 GHz, 19.25MB, TDP 105W), Gold 5122(4C/8T, 3.60 GHz, 16.50MB, TDP 105W), Gold 6126(12C/24T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 125W), Gold 6128(6C/12T, 3.40 GHz, 19.25MB, TDP 115W), Gold 6130(16C/32T, 2.10 GHz, 22MB, TDP 125W), Gold 6132(14C/28T, 2.60 GHz, 19.25MB, TDP 140W), Gold 6134(8C/16T, 3.20 GHz, 24.75MB, TDP 130W), Gold 6136(12C/24T, 3 GHz, 24.75MB, TDP 150W), Gold 6138(20C/40T, 2GHz, 27.50MB, TDP 125W), Gold 6140(18C/36T, 2.30 GHz, 24.75MB, TDP 140W), Gold 6142(16C/32T, 2.60 GHz, 22MB, TDP 150W), Gold 6148(20C/40T, 2.40 GHz, 27.50MB, TDP 150W), Gold 6152(22C/44T, 2.10 GHz, 30.25MB, TDP 140W), Platinum 8160(24C/48T, 2.10 GHz, 33MB, TDP 150W), Platinum 8164(26C/52T, 2GHz, 35.75MB, TDP 150W)			
	標準搭載数 / 最大搭載数	0/2			
	コントローラー・ハブとの接続	DMI3 (8GB/s)			
	インテル®バーチャライゼーション・テクノロジー	対応			
	インテル®ハイパー・スレッディング・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106 は除く)			
インテル®ターボ・ブースト・テクノロジー	対応 (Xeon Bronze 3104/3106 は除く)				
チップセット		インテル® C622 チップセット			
メモリ	搭載容量 標準 / 最大	標準搭載なし(セレクトラブルオプション) / Registered DIMM : 512GB (16x 32GB), Load Reduced DIMM : 1TB (16x 64GB)			
	搭載メモリ	DDR4-2666 Registered DIMM (8/16/32GB), DDR4-2666 Load Reduced DIMM (64GB)			
	最大動作周波数	2666MHz (CPU 毎の最大動作周波数はシステム構成ガイドを参照願います)			
	誤り検出・訂正	ECC, x4 SDDC			
	メモリスベアリング	対応			
メモリミラーリング	対応				
補助記憶装置	ドライブ	内蔵	フロント 8x 2.5 型ドライブ 2x 2.5 型ドライブ(オプション最大 1 個))	4x 3.5 型ドライブ	
		スロット	リア	—	
			内部	—	
	内蔵標準	—			
	ベイ	内蔵最大	2.5 型 HDD: SATA 20TB (10x 2TB), SAS 18TB (10x 1.8TB) 2.5 型 SSD: SATA 38.4TB (10x 3.84TB), SAS 8TB (10x 800GB) (オプション HDD ケージ追加時)	3.5 型 HDD : SATA 40TB(4x 10TB), ニアライン SAS 40TB(4x 10TB)	
		ホットスワップ	対応		
	インターフェース規格と RAID 構成		SATA 6Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション), SAS 12Gb/s : RAID 0/1/5/6/10/50/60 (オプション)		
光ディスクドライブ		内蔵/外付ドライブ接続 (オプション) *1			
FDD		オプション: Flash FDD (1.44MB)*2			
拡張ベイ		—			
拡張スロット	対応スロット	標準ライザなし			
		1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (RAID コントローラ専用) 1x PCI Express 3.0 (x8 レーン, x8 ソケット) (LOM カード専用) (オプションのライザカードを手配することで PCI 構成を変更可能です。詳細はシステム構成ガイドを参照ください。)			
グラフィックス	搭載チップ / ビデオ RAM	マネージメントコントローラチップ内蔵 / 16MB			
	グラフィック表示 と 解像度	640x480, 800x600, 1,024x768, 1,280x1,024, 1,600x1,200, 1,920x1,200			

標準インターフェース	フロント	1x USB3.0(Type A) *3, 1x USB2.0(Type A) (BMC 用)	
	リア	2x USB3.0 (TypeA) , 1x アナログ RGB (ミニ D-Sub15 ピン), 1x マネージメント専用 LAN コネクタ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応, RJ-45) 2x データ LAN コネクタ (1000BASE-T のみ対応 (RJ-45)) 1x シリアルポート (オプション)	
	内部	1x USB3.0 (TypeA), 2x SATA 2.0 Port, 3x miniSAS Port	
キーボード・マウス		オプション	
冗長電源		対応 (オプション, ホットプラグ可)	
冗長ファン		対応 (オプション)	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ)		434.6mm x 614.9mm x 42.9mm (フロントベゼル/レール/突起物含まず)	
質量 (最小 / 最大)		12kg / 25kg	13g / 26kg
電源		<p>選択必須オプション</p> <p>AC 電源ユニット(TN8181-168T)</p> <p>500W 80 PLUS Gold 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ不可) (最大 : 1)</p> <p>AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (電源ケーブルは必須選択オプション)</p> <p>AC 電源ユニット(TN8181-159T/ 160T)</p> <p>500W/800W 80 PLUS Platinum 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2)</p> <p>AC100-120V/200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (1xAC200V 用電源ケーブル(ケーブル長:2m, プラグ形状:IEC320 C14) 付属)</p> <p>AC 電源ユニット(TN8181-161T)</p> <p>800W 80 PLUS Titanium 取得電源 (二極並行アース付きコンセント) (ホットプラグ可) (最大 : 2)</p> <p>AC200-240V±10%, 50/60Hz±3Hz (1xAC200V 用電源ケーブル(ケーブル長:2m, プラグ形状:IEC320 C14) 付属)</p>	
消費電力(100V 最大構成時, 最大電力)		896VA / 895W	846VA / 845W
消費電力(200V 最大構成時, 最大電力)		863VA / 863W	816VA / 816W
省エネ法(2011 年度基準)に基づくエネルギー消費効率 (W/GTOPS) *4		対象外 *5	
音量	音圧レベル(100V 最大構成時, 高負荷時)	38.9dB	
温度/湿度条件		動作時: 10~35°C, 保管時: -30~60°C/ 動作時: 8~90%, 保管時: 5~95% (動作時/保管時ともに結露しないこと)	
主な添付品		スタートアップガイド, 保証書, フロントベゼル	
対応 OS	Windows	Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard, Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter, Microsoft® Windows Server® 2016 Standard, Microsoft® Windows Server® 2016 Datacenter	
	Linux	Red Hat® Enterprise Linux® 7.3 以降	
	VMware	VMware ESXi™ 6.0 Update3, VMware ESXi™ 6.5 Update1	

\*1 : 内蔵光ディスクドライブをシステムに搭載しない場合、保守時および OS 再インストール時に備えて外付ディスクドライブを全システムで最低 1 式は必ず手配してください。

\*2 : 必要に応じて購入してください。主な用途については構成ガイドを参照下さい。

\*3 : VMware ESXi 6.0 をインストールした場合、USB2.0 で動作します。

\*4 : 省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネルギー法で定める複合理論性能(単位:ギガ演算)で除したものです。

\*5 : 省エネ法(2011 年度目標基準)の規制対象外です。

製品環境諸元一覧

国際エネルギースター計画基準への適合 (Y/N)		適合予定	
低電力モード消費電力(W)		53.3	56.5
グリーン購入法特記事項(2015年2月閣議決定)		対象外	
省エネ法関連特記事項		省エネ法規制対象外 *6	
リサイクル設計 (Y/N)		Y	
再生プラスチック材料使用	再生プラスチック材の使用 (Y/N)	N	
	使用箇所	-	
リサイクル関連特記事項		25g 以上の本体樹脂部品の一部に材料表示	
取扱説明書における再生紙使用 (Y/N)		- (紙媒体の添付無し)	
特定臭素系難燃剤(PBBs, PBDDOs, (PBDEs))の不使用 (Y/N)		Y	
塩ビ(PVC)の不使用 (Y/N)		N	
梱包材への発泡剤の不使用 (Y/N)		N	
梱包材への PVC の不使用 (Y/N)		Y	

\*6: 200GTOPS を超えるため省エネ法(2011 年度目標基準)規制対象外です。